

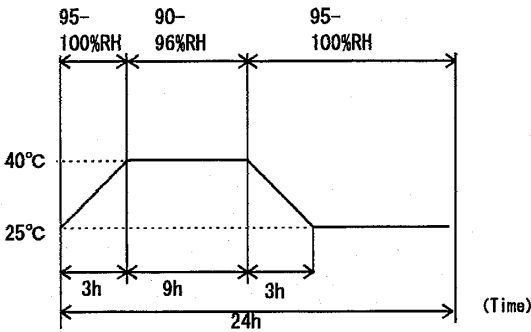
JAPAN AVIATION ELECTRONICS IND., LTD. CONNECTOR DIVISION 日本航空電子工業株式会社 コネクタ事業部 THIS SPECIFICATION TABLE CANNOT BE REPRODUCED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF JAE. この製品規格表は日本航空電子工業株式会社の 許可のない限り複写を禁じます。			SPECIFICATION TABLE 製品規格表		Connector Specification No. JACS-10580	
					Connector Series Name 品名 ST1W008S4G/K/R/T	
					Applicable Drawing No. 製品図面 SJ109285-6, SJ110368-9, SJ110892-3, SJ111744-5	
					TK C	
Rev. 版数	Date 発行日	DCN No	Drawn by 担当	Checked by 査閲	Approved by 承認	
1	6 Jan. 2010	-	M. SHIMADA	-	A. NATORI	
2	30 Jul. 2010	070421	K. SAKUMA	M. SHIMADA	A. NATORI	
3	16 May 2011	072069	M. SHIMADA	-	A. NATORI	
4	16 Jun.2021	CN-040261	S.TOMITSUKA	K.UEDA	M.SHIMADA	
Standard data 定格						
Rated current 電 流		0.5A Max.				
Rated voltage 電 圧		10V Max.				
Operating temperature range 使用温度範囲		-40℃ ～ +85℃				
Storage temperature range 保存温度範囲		-40℃ ～ +85℃				
Strage life after delivery 納入後使用期限		6 months 6 ヶ月（製造日起算の総保管期限は 2 年間とする）				
備考 各試験は、指示が無い限り、適合カード（microSD または TransFlash）との接触状態にて行う。 Each test for connectors should be carried out in contacting to applicable microSD cards.						
Item		Procedure 試験方法			Requirement 規定	
MECHANICAL 機械的性能						
Examination of product 構造寸法表示					Meets requirements of product drawing. 図面と相違なきこと。	
Durability 寿命試験		10,000 cycles with card at the speed rate of 400~600 cycles/hour. (1 Cycle =Cover Opening and Closing with card inserted) カード挿抜を 10,000 サイクル繰り返す。 速度：400～600 サイクル／時間 (1 サイクル＝カード挿入状態のカバーを開け閉めする)			No mechanical damage It should meet contact resistance requirement after test. 機械的損傷なきこと。 試験後、接触抵抗を満足すること。	
Drop 落下試験		Height：1.8m Floor：P-tile Direction/Count：6planes dropping, 3times each (total: 18times) Specimens should be included in the chassis. 落下高さ：1.8m 落下床面：P-タイル 落下方向及び回数：6面落下、各3回(計18回) 筐体組込み状態にて試験を実施			No mechanical damage. 機械的損傷なきこと。	

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
Vibration 振動	IEC 60068-2-6 Fc Amplitude : 10mm, Acceralation : 24.5m/s ² or 10mm Wavelength : 10-2000-10Hz/15min. cycle : 10/axis (150min), 3axes (total: 450min) Test current : 1mA IEC 60068-2-6 Fc に準拠 加速度 : 24.5m/s ² または、振幅: 10mm 周波数 : 10~2000~10Hz/15min. サイクル : 各軸 10 サイクル(150min)、3 軸 (計 450min) 試験電流 : 1mA	No electrical discontinuity more than 0.1 μ s. It should meet contact resistance after the test. 試験中、電気の瞬断は 0.1 μ s 以下であること。 試験後、接触抵抗を満足すること。
Shock 衝撃	IEC 60068-2-27 Ea, Half sine curve 490m/s ² , 11ms 1 axis, plus-minus direction, core 3 times (total: 18times)  Test current: 1mA IEC 60068-2-27 Ea に準拠 半波正弦波 加速度 : 490m/s ² , 作用時間 : 11ms 1 軸、正負方向、各 3 回 (計 18 回) 試験電流 : 1mA	No electrical discontinuity more than 0.1 μ s. It should meet contact resistance after the test. 試験中、電気の瞬断は 0.1 μ s 以下であること。 試験後、接触抵抗を満足すること。
Cover Pushing Down Force カバー加圧強度	Center of Cover upper surface pushed down with round bar in 4mm diameter.(without card) Force : 10N Time : 1s Cycle : 3 times 天面中央にΦ4 の円柱を押し当てる (カード非嵌合にて実施) 印加荷重 : 10N 加圧時間 : 1s 回数 : 3 回	No crack. It should be possible card locking after the test. 割れ等、有害な破壊なきこと。 試験後、カードロック可能であること。
Cover Operating Force カバー操作力	Measure the cover shifting force at open/close カバー開閉時の操作荷重を測定する	7N max.
Cover Pulling Off and Pushing Out Force カバー外れ強度	Measure the cover pulling off and pushing out force See fig. 3.  引張、横押しにてカバーが外れるときの荷重を測定する (図 3) 	Pulling off : 5N min. Pushing out : 2N min. No mechanical damage in housing. 引張荷重 : 5N 以上 横押し荷重 : 2N 以上 ハウジングに機械的損傷無きこと。

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

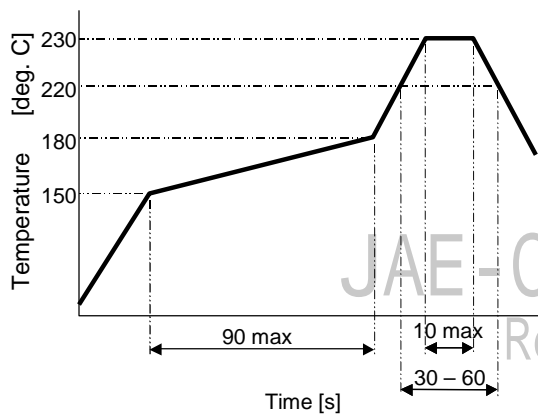
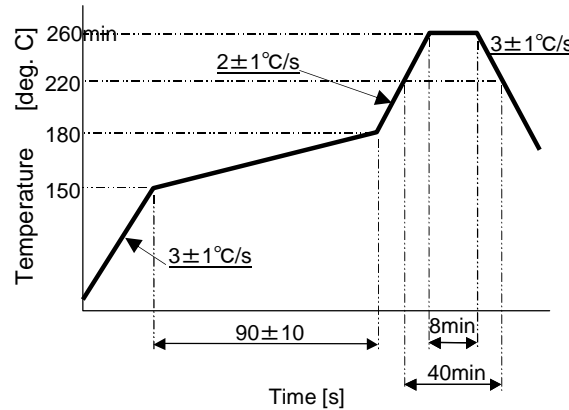
Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
ELECTRICAL 電気的性能		
Contact Resistance 接触抵抗	IEC 60512-2-2 Test current: 10mA  Open voltage: 20mV IEC 60512-2-2 に準拠 試験電流: 10mA 開放電圧: 20mV	<Signal> Initially: 100mΩMax. After test: 40mΩMax. change <Switch> Initially: 500mΩMax. After test: 500mΩMax. change <信号> 初期: 100mΩ以下 試験後: 変化量 40mΩ以下 <スイッチ> 初期: 500mΩ以下 試験後 変化量 500mΩ以下
Insulation Resistance 絶縁抵抗	IEC 60512-2-3 Apply 500V DC between adjacent contacts and measure the insulation resistance. IEC 60512-2-3 に準拠 近接コンタクト間に DC500V を印加し、絶縁抵抗を測定する。	Initial: : 1000MΩ (Min.) After test: : 100MΩ (Min.) 初期 : 1000MΩ以上 試験後 : 100MΩ以上
Dielectric Withstanding Voltage 耐電圧	IEC 60512-2-4 Apply the specified voltage between adjacent contacts. IEC 60512-2-4 に準拠 近接コンタクト間に規定電圧を印加する。	AC 500V rms. No breakdown caused for 1minute. AC500V rms. 1 分間異常の無いこと。
Temperature Rise 温度上昇	IEC-512-3-5a Test current : 0.5A/contact IEC-512-3-5a に準拠 試験電流 : 0.5A/1 端子	30 degree-C rise MAX 上昇温度 30℃以下

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
ENVIRONMENTAL 環境的性能		
Dry Heat (Steady state) 高温放置	+85°C、96h	It should meet contact resistance after the test. 試験後、接触抵抗を満足すること。
Dry Cold (Steady state) 低温放置	-40°C、96h	
Dry Heat (Operating state) 高温動作	+60°C、96h 3.3V、1mA applied current	
Dry Cold (Operating state) 低温動作	-20°C、96h 3.3V、1mA applied current	
Damp heat (Steady state) 耐湿性 (開封後保管条件)	60°C,90%RH,96h	It should meet electrical requirement after the test. 試験後、電気的要求性能を満足すること。
高温高湿動作	+40°C,95%RH,168h 3.3V、1mA applied current	
Damp Heat 温湿度サイクル	IEC 60068-2-30 Db, 10 cycles IEC 60068-2-30 Db に準拠。10 サイクル  <p>The graph shows a 24-hour cycle with three phases: 3h at 25°C/95-100%RH, 9h at 40°C/90-96%RH, and 3h at 25°C/95-100%RH. The temperature ramps up and down between 25°C and 40°C.</p>	
Thermal Shock (Change of temperature) 熱衝撃	IEC 60068-2-14 Na -55°C/30min~+85°C/30min 100 cycles -55°C/30min~+85°C/30min 連続 100 サイクル	No mechanical damage. It should meet electrical requirement after the test. 試験後、機械的損傷なきこと。 試験後、電気的要求性能を満足すること。

JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only

Item	Procedure 試験方法	Requirement 規定
Hydrogen Sulfide	IEC 60068-2-43 Kd Concentration : 3 ± 1 ppm Test temperature : $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ Test period : 96 ± 4 h <without card>	It should meet the contact resistance after the test.
H ₂ S ガス	IEC 60068-2-43 Kd に準拠 ガス濃度 : 3 ± 1 ppm 温度 : $40 \pm 2^{\circ}\text{C}$ 時間 : 96 ± 4 h <カード非嵌合状態にて実施>	試験後、接触抵抗を満足すること。
Soldering Heat Resistance	2 times on below profile. PWB thickness : 1mm (FR-4) Solder thickness : 0.1mm Solder composition : Sn-3.0Ag-0.5Cu 下記プロファイルを 2 回実施 基板厚さ : 1mm (FR-4) クリーム半田厚さ : 0.1mm クリーム半田組成 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	No mechanical damage. No open joint 機械的損傷なきこと。 端子の半田未着無きこと。
Solderability	1 time on below profile. PWB thickness : 1mm (FR-4) Solder thickness : 0.1mm Solder composition : Sn-3.0Ag-0.5Cu 下記プロファイルを 1 回実施 基板厚さ : 1mm (FR-4) クリーム半田厚さ : 0.1mm クリーム半田組成 : Sn-3.0Ag-0.5Cu	Solder should be covered on more than 95% area dipped without cutted surface. 浸漬面積の 95%以上が半田で覆われること。 但し、切断面(信号端子先端を除く)



●STENCIL HOLE SIZE マタルマスク開口率

ALL STENCIL HOLE SIZES ARE SAME AS LAND SIZES

●Lot No.

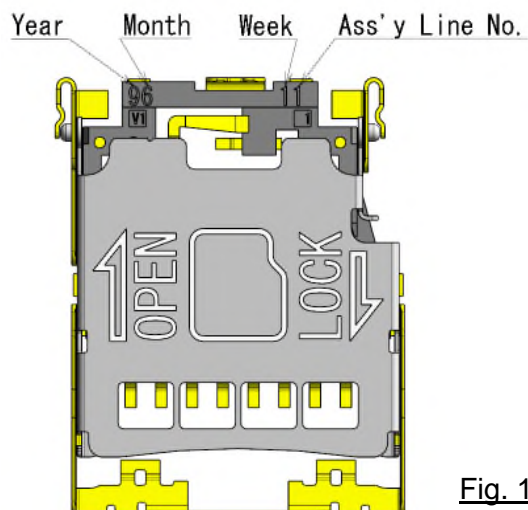


Fig. 1 Lot No.

●落下方向

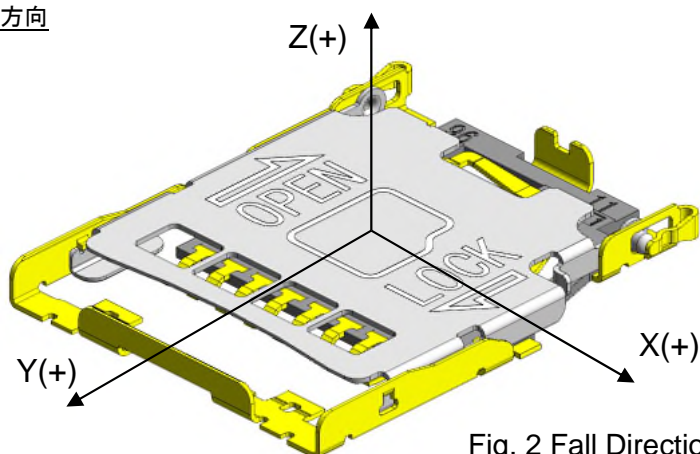


Fig. 2 Fall Direction

●カバー外れ強度測定方法

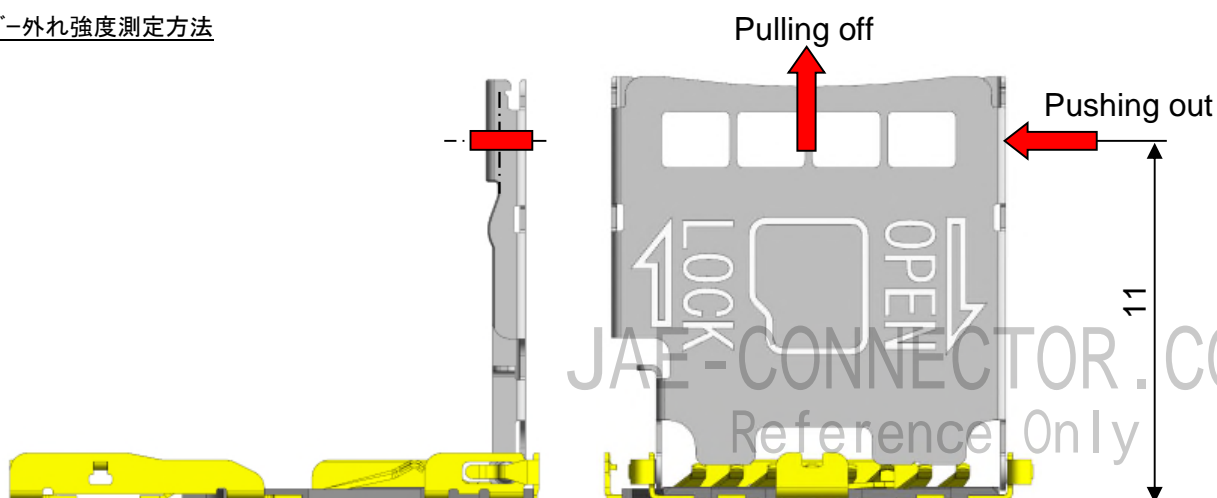
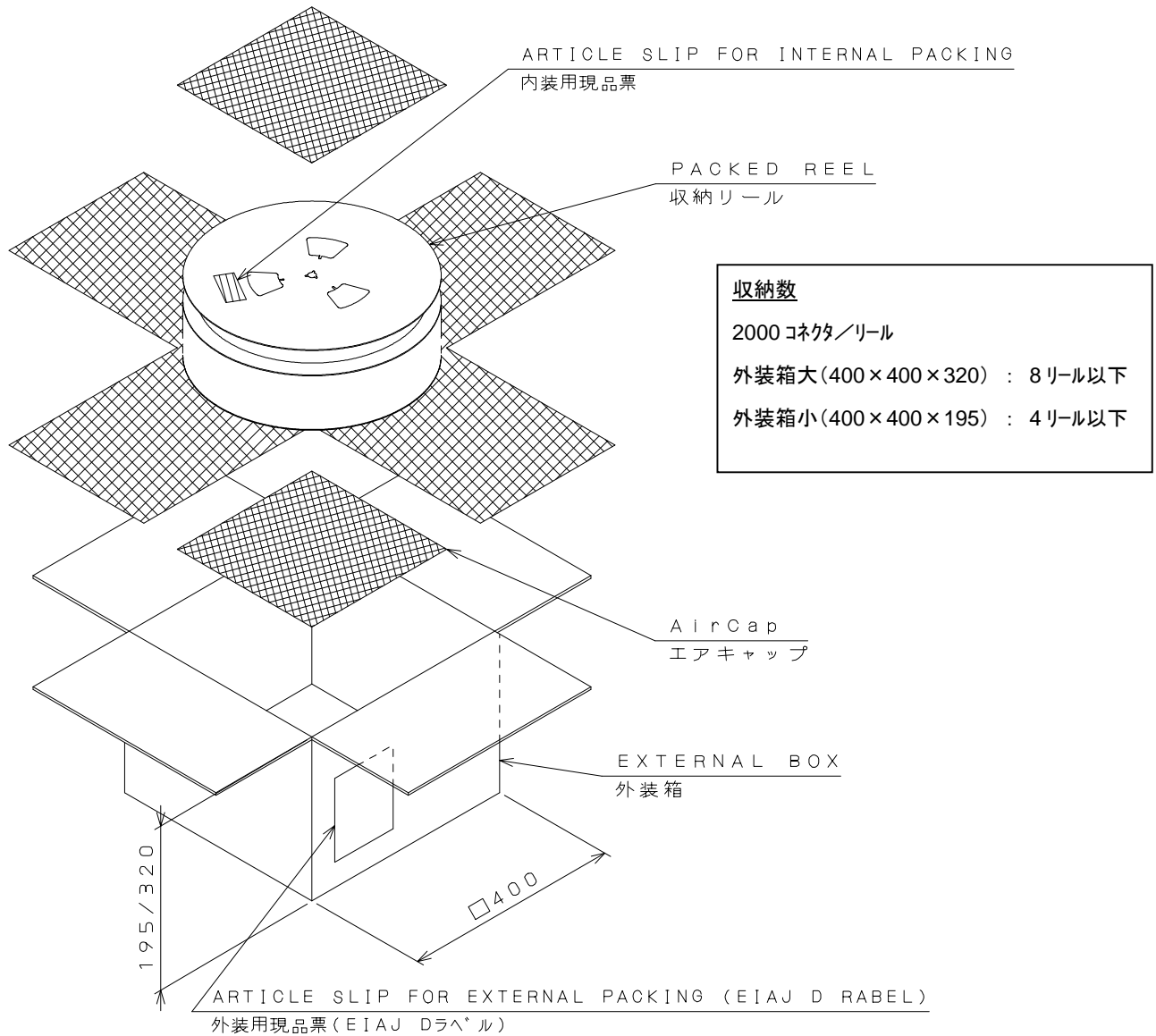


Fig. 3 Measurement Method of Cover Pulling off / Pushing out Force

●Packing 梱包仕様(外装)



JAE-CONNECTOR.COM
Reference Only